线阵图像采集主机返修报告

|  |  |
| --- | --- |
| 名称：线阵图像采集主机 | 型号：GX3-HS-01B |
| 返修单位：北京铁科英迈技术有限公司 | 序列号：UA211213 |
| 维修单位：北京主导科技有限公司 | 返修日期：2025.03.23 |
| 故障描述：   1. 计算机运行软件后,CPU温度高，影响性能 | |
| 故障确认：   1. 计算机运行软件后,CPU温度高，影响性能 2. 压力测试后散热片发热不均匀，怀疑CPU与散热片接触不良 | |
| 解决方案：  使用烤机软件压力测试，压力测试后散热片发热不均匀，怀疑CPU与散热片接触不良。去除独立显卡测试，压力测试，现象一致。  散热硅脂压痕压力大，硅脂溢出接触面，导致硅脂不完全贴合，导致接触良，影响CPU到散热片散热效能，导致CPU温度过高。  散热器和CPU晶体上硅脂，怀疑由于散热硅脂接触不良造成散热效率差。更换散热硅脂后测试温度回复正常。 | |
| 是否解决：  **已解决** | |
| 检测人：01 | 日期：2025.03.25 |
| 交货负责人：杨斐  日期：2025.03.25 | 收货负责人：  日期： |